

# 松江经济技术开发区管理委员会文件

松经开〔2024〕257号

签发人：顾军

## 松江经济技术开发区管理委员会 关于支持上海新阳半导体材料股份有限 公司规划调整的请示

松江区规划和自然资源局：

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称：新阳半导体）于2004年落户于松江区工业区科技园区（思贤路3600号），地块面积80.5亩，地块容积率1.6，限高24米，现有厂房建筑面积37183平方米。

该公司主要为我国集成电路产业提供产品和服务，其中电子电镀与电子清洗核心技术与产品，是国内唯一一家对芯片90至14纳米各技术节点在铜互连工艺全满足的本土企业；公司的高选择刻蚀核心技术与产品，在存储芯片刻蚀工艺已达到全球领先水平，生产规模由建厂初期的年产2000吨集成电路关键工艺

材料产品，逐步壮大发展成现年产 19000 吨规模，现已满负荷运转，预计今年营业收入将突破 10 个亿。近几年年营收复合增长率均超过 30%，呈现可持续增长态势。

基于对未来市场需求及公司发展规划考量，新阳半导体计划将现有建筑面积提升至 75813.56 平方米，以实现 20000 吨集成电路关键工艺材料扩产目标。由于该地块上现有建筑容积率已达到 1.41，合同约定容积率为 1.6，故该司申请将容积率调整至 2.0，高度 50 米，拟计划新建、改扩建综合研发楼、生产厂房、配套仓储用房，新增建筑面积约为 46587 平方米。

新阳半导体项目计划总投资 5 亿元，其中固定资产投资 4.5 亿元。项目达产后，年平均增加营业收入 6 亿元，年平均增加利润 5000 万元，年平均增加上缴各项税费 4000 万元。

项目建成后将提升企业的竞争力，带动上下游企业发展，促进区域经济发展，故恳请贵局对项目的规划调整申请予以支持。

特此请示！

- 附件：1. 新阳半导体调规经委复函（沪松经〔2024〕346号）
2. 上海新阳总图 2024.11.7-更新-修改 1(1)
3. 新阳半导体调规申请

(此页无正文)

